

CF-E11 考核項目清單

1. 使用前檢查機台狀況？
 - a. 燈號、機台狀況標示
2. 貼片時注意事項？
 - a. 先將載片背面用 IPA 擦拭乾淨
 - b. 放在乾淨無塵布上
 - c. 再開始貼片
 - d. 若載片正面已經髒汙，則更換載片
3. 各腔體功能？
 - a. PM1:?
 - b. PM2:?
 - c. PM3:?
4. 限制材料：a. 磁性記憶體材料。b. 貴金屬類材料。c. IIIIV 材料(Ga、In)
5. Recipe 選定與參數修改？
 - a. 如何從主畫面下 run 頁面連接至 recipe 頁面？實際操作
 - b. 如何判斷蝕刻步驟：RF power on
 - c. 如何修改製程時間：實際操作
 - d. De-chuck step 作用為何？去除靜電，切勿更改到 de-chuck 參數
6. He 背壓用途與數值異常(變高)原因？
 - a. He 背壓功能：使 wafer 溫度均勻
 - b. He 背壓變大原因：晶背髒、晶片變形(少見)
 - c. 如何防止 He 背壓變大：使用前務必先將晶背擦拭乾淨
7. Alarm 處理流程？
 - a. 先讓 alarm 重新執行：先從 retry、restart、continue 選擇
 - b. 若無法解除，則將 wafer 傳回來：選回傳 wafer 的項目
 - c. 若無法回傳，先回主畫面按 Abort，先將還沒做的 wafer 回傳
 - d. 掛紅牌，留下聯絡方式
 - e. 若是遇到 沒看過、不確定、無法理解的 alarm 訊息，
不曉得如何選擇的話：直接掛紅牌，留下聯絡方式
8. 下錯 recipe 處理方法？
 - a. Abort 將晶片退回
 - b. 手動跳過蝕刻 ME 步驟